（上接D31版）

截至2025年12月31日，公司存货库龄结构如下：

金额：人民币 万元

项目	账面余额	占比	存货跌价准备	跌价准备计提比例
原材料	108,878.04	100.00%	3,151.04	2.89%
其中：1年以内	80,431.71	73.87%	1,478.47	1.84%
1年以上	28,446.33	26.13%	1,672.57	5.88%
在产品	29,318.46	100.00%	3,388.50	11.56%
其中：1年以内	29,287.36	99.89%	3,357.40	11.46%
1年以上	31.10	0.11%	31.10	100.00%
产成品	92,615.75	100.00%	27,669.69	29.88%
其中：1年以内	76,837.18	82.96%	13,746.66	17.89%
1年以上	15,778.57	17.04%	13,923.03	88.24%
合计	230,812.25	100.00%	34,209.23	14.82%
其中：1年以内	186,556.25	80.83%	18,582.53	9.96%
1年以上	44,256.00	19.17%	15,626.70	35.31%

2025年末，公司存货库龄以1年以内为主，1年以内库龄金额为186,556.25万元，占比80.83%。

其中，库龄超过1年的原材料金额为28,446.33万元，占原材料总额的26.13%，主要包括备品备件和电子级多晶硅。半导体硅片生产所需的上游原材料，尤其是电子级多晶硅及关键设备备品备件，供应商较为集中，其供求与价格存在波动。为保障生产连续性和稳定性，公司与核心供应商签订长期供货协议，并结合市场需求提前进行备货，且为应对潜在贸易风险而保有安全库存。该类原材料保质期相对较长，在基本技术方案、主要原材料配置没有发生重大变化的情况下，能够用于后续的产品生产，可以随生产不断耗用，不存在长期积压的情形。

库龄超过1年的产成品金额为15,778.57万元，占产成品总额的17.04%。公司采取“以销定产、适量备货”的生产模式，结合每年公司对未来市场的预测进行备货调整，因此会有一定规模的产成品库存。随着公司产能的扩大，库龄超过1年的产成品金额随之有所增加，但整体占比可控，公司对长库龄的产成品密切监控，实行差异化的存货跌价策略。

2、存货周转率变化

公司主要采用“以销定产、适量备货”的生产模式，结合下游客户订单需求，统筹安排批量生产计划，同时根据市场需求预测、产品迭代周期及客户交付周期，进行一定备货式生产，平衡订单交付效率与库存合理水平，更好地匹配和满足客户的备货需求。2025年，公司存货周转天数约为160天，与2024年相比未发生重大变化，整体存货周转保持平稳。

与同行业可比公司相比，公司存货周转率居于行业合理水平。

公司	2025年度	2024年度
西安奕材	1.83	1.69
中欣晶圆	2.33	2.14
TCL中环	3.90	3.51
立昂微	1.98	1.79
可比公司	1.83-3.90	1.69-3.51
沪硅产业	2.17	2.27

注：存货周转率=营业成本/期初存货原值/2+期末存货原值/2）

3、同行业可比公司存货跌价准备计提比例

2025年年末公司的存货跌价准备计提比例为14.82%，与可比公司不存在重大差异。其中：产成品计提的存货跌价准备比例可比公司在23.43%到40.45%之间，公司计提比例为29.88%；原材料和在产品可比公司的计提比例本身存在较大差异，原材料从3.11%到15.57%，在产品从15.85%到42.36%，公司计提的比例接近可比公司，差异原因主要是各半导体硅片厂商的经营业务相近但仍存在一定差异，且原材料和在产品的库存结构也可能存在一定差异。

可比公司	原材料	在产品	产成品	整体存货
西安奕材	3.11%	15.85%	23.43%	11.40%
中欣晶圆	15.57%	42.36%	40.45%	33.98%
TCL中环	7.66%	24.88%	29.83%	18.38%
立昂微	3.59%	18.66%	24.81%	12.66%
沪硅产业	2.89%	11.56%	29.88%	14.82%

注：以上数据来源于可比公司公告的2025年年报。

4、产品市场价格走势

受到行业周期性波动以及市场竞争加剧的影响，报告期内公司产品价格整体呈下降趋势，公司在2025年末存货跌价测试中已充分考虑行业周期性下行及市场竞争格局变化对产品价格的影响。

假设2025年度各产品大类的实际售价指数为100，2025年末存货跌价测试用的估计售价和期后实际售价以2025年度实际售价的指数为基础计算。

经对比，预计售价与期后实际售价整体不存在重大偏离，公司一些主要产品情况列举如下：

半导体硅片尺寸	产品大类	具体分类	2025年度实际售价	估计售价	期后实际售价
300mm	抛光片	A1	100	98	95
		A2	100	97	92
	外延片	B1	100	99	90
		B2	100	87	92
200mm及以下	外延片	C1	100	83	114
		C2	100	100	105
		C3	100	101	98
		C4	100	109	100

综上，截至2025年12月31日，公司的存货结构稳定符合业务实际需要，存货周转率不存在重大变化，公司用于测算存货跌价准备的估计售价符合产品价格趋势，已充分、审慎的计提相关存货跌价准备，与同行业可比公司不存在重大差异，符合公司的实际经营情况。

5、进一步减值风险及公司应对措施

（1）进一步减值风险提示

公司已在2025年年报财务风险章节中提示：“截至2025年12月31日，公司存货总额为230,812.25万元，存货跌价准备金额为34,209.23万元，占比为14.82%。随着公司业务规模的快速增长，存货的绝对金额将随之上升。若公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能如期推进客户认证进度，就可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。”

（2）公司的应对措施

针对存货减值的风险，公司已建立并持续完善多维度的存货管理体系，具体应对措施如下：

公司密切跟踪下游客户需求变化及行业趋势，结合在手订单、客户预测及市场公开信息，动态调整生产排产计划与安全库存水平，合理控制存货总量，避免因过度备货导致的库存积压风险。

公司严格管理长库龄的产成品，积极匹配客户需求，加速但谨慎消化长库龄的产成品，避免因不恰当处理长库龄的产成品给公司带来损失。

公司持续推动产品结构优化，深化与核心客户的战略合作并积极拓展优质客户资源，增强下游需求的稳定性，降低市场波动对存货价值的不利影响。

公司严格按照企业会计准则的要求，于每个资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货价值。对于库龄较长、市场需求已发生重大不利变化或售价持续走低的存货，基于谨慎性原则足额计提跌价准备，确保财务信息的真实性和准确性。

（六）按照硅片尺寸、进一步拆分列示固定资产中用于生产不同尺寸硅片的机器设备账面原值、累计折旧、减值准备、账面价值，并说明在8英寸及以下硅片竞争加剧、行业向12英寸过渡的情况下，相关固定资产减值计提的充分性。

1、固定资产中用于生产不同尺寸硅片的机器设备账面原值、累计折旧、减值准备、账面价值的具体情况如下：

单位：人民币 亿元

机器设备	12英寸（300mm）	8英寸（200mm）及以下
账面原值	114.32	39.44
累计折旧	-24.87	-15.44
减值准备	-	-0.28
账面价值	89.45	23.72

2、在8英寸及以下硅片竞争加剧、行业向12英寸过渡的情况下，相关固定资产减值计提的充分性

（1）行业情况及公司应对

当前半导体硅片行业呈现明显的结构性迭代特征，一方面，300mm半导体硅片凭借更高的经济效益和技术优势，已成为市场绝对主流，出货面积占比持续提升，在AI、高性能计算、先进存储等需求驱动下保持增长态势；另一方面，200mm及以下半导体硅片市场面临半导体行业下行周期下终端消费电子、传统工业电子等领域阶段性需求疲软与竞争加剧的双重压力。

从行业基本面来看，尽管行业整体向大尺寸化过渡，300mm半导体硅片是行业长期发展主流，但200mm及以下半导体硅片仍具备坚实的存量基础与刚性增量空间。从应用端看，200mm工艺平台凭借制程成熟、产品稳定性高、产线设备折旧完毕带来的综合成本优势，在功率器件、电源管理器、传感器、显示驱动芯片、指纹识别芯片及汽车电子、物联网、工业电子等领域仍具有不可替代性。SEMI预测，全球200mm晶圆厂产能仍将有所扩张，至2027年将达到780万片/月的历史新高。

面对200mm及以下半导体硅片领域需求疲软、行业竞争加剧、行业迭代加速的多重挑战，公司立足自身技术积淀与产品布局，多措并举夯实存量业务、培育新增量，实现成熟业务稳健经营与业务结构转型升级。一方面，公司持续推进200mm及以下硅片（含SOI）产品升级与技术迭代，聚焦高性能应用，顺应汽车及工业产业链国产化趋势，力争在IGBT/FRD等产品应用市场获得更广泛渗透，优化产品结构，摆脱低端同质化价格竞争，提升成熟尺寸产品的技术壁垒与盈利水平，并加大对海外市场的开拓力度；另一方面，公司坚持差异化竞争策略，依托子公司Okmetic特色工艺优势，深耕传感器、射频、高压模拟、功率器件等高端细分赛道，精准匹配下游高附加值领域的定制化需求，打造差异化产品竞争力，稳固高端细分领域200mm及以下半导体硅片市场份额。同时，公司主动顺应行业大尺寸迭代趋势，积极布局新兴核心增长点，全力推进300mm半导体硅片及300mm SOI硅片产能建设与量产落地，聚焦硅光、AI算力、高压射频、先进存储等新兴高景气领域，加速高端大尺寸产品客户验证与批量出货，逐步优化整体业务结构，对冲8英寸及以下业务的行业压力。此外，公司持续深化产学研协同与客户深度绑定，依托持续的研发投入持续优化工艺、提高生产效率、丰富产品组合，通过规模化生产降本增效，持续提升公司在成熟制程与先进制程领域的综合竞争力，实现公司硅片业务的长期稳健发展。

（2）200mm及以下产品对应的机器设备已计提减值准备的情况

截至2025年12月31日，200mm及以下尺寸产品对应的机器设备原值39.44亿元，累计折旧15.44亿元，已计提减值准备0.28亿元，其中包括：因拟进行淘汰的外延设备根据其预计处置价格作为公允价值减去预计处置费用计提的固定资产减值准备约0.11亿元；因新傲科技向Soitec提供SOI受托加工服务，该业务直接受Soitec的需求影响，2025年度下滑显著且对2026年的预期较低，公司依据对新傲科技的SOI业务未来需求情况的预测进行可收回金额的测算，计提相应固定资产减值准备0.17亿元。

（3）固定资产减值准备计提充分性

对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额并进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

公司结合业务经营以及《企业会计准则第8号——资产减值》关于减值迹象的规定，对200mm及以下固定资产是否存在减值迹象进行了分析。经判断，除（2）所述固定资产外，未发现其他资产存在减值迹象，具体说明如下：

序号	企业会计准则规定	公司实际情况	是否存在减值迹象
1	资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。	报告期内，公司固定资产、在建工程均处于正常使用或建设状态，且未发现原有各资产当期市价出现大幅度下降的情况。	否
2	企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。	全球半导体硅片市场呈现结构性分化态势。总体而言，200mm硅片市场需求具备长期韧性，且公司通过市局面向高端细分领域的定制化产品和发展SOI硅片等新产品及海外扩产，在探索新的结构性机遇的同时，进一步巩固全球市场份额，公司所处行业的经济、技术及法律环境在近期未发生重大不利变化，未对公司生产经营构成实质性不利影响。	否
3	市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。	报告期内，国内市场基准利率并未发生大幅上调的情况	否
4	有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。	设备使用及保管情况较好，不存在相关资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏的情况	否
5	资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。	未出现已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情况；也未出现建设进程停滞、延迟等情况。	否
6	企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。	公司业务发展紧贴市场变化，随着行业需求回暖、产品结构优化、新客户认证的推进，200mm业务盈利能力有望在未来逐步改善。不存在固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期等情况。	否
7	其他表明资产可能已经发生减值的迹象。	未发现存在其他有可能表明资产已发生重大减值的情况。	否

综上，公司已按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，于报告期末对固定资产是否存在减值迹象进行了审慎评估，并对存在减值迹象的资产执行了减值测试。经测试，对于可收回金额低于账面价值的部分，已相应计提资产减值准备。公司固定资产减值计提充分、合理，符合企业会计准则的要求。

（七）会计师核查程序和核查意见：

1、核查程序

（1）针对商誉减值测试我们实施的审计程序主要包括：①了解和评估管理层有关商誉减值测试的内部控制；②评估管理层聘用的外部评估师的胜任能力、专业素质及客观性；③评估管理层对商誉所在资产组的确认是否恰当；④参考行业惯例和估值技术，评估管理层商誉减值测试的方法是否恰当；⑤评估未来现金流预测中所使用的关键假设及参数，包括预计收入增长率、毛利率等是否合理；⑥在内部估值专家的协助下，评估管理层采用的未来现金流量折现模型和折现率是否恰当；

（2）针对存货跌价测试我们实施的审计程序主要包括：①了解公司存货跌价准备计提政策，判断是否符合企业会计准则的要求，并与同行业对比是否存在重大差异；②了解公司可变现净值的确定方法、关键参数及其选取依据，与同行业对比是否存在重大差异，执行重新计算等程序检查具体执行的准确性；③获取公司存货库龄表，分析公司的存货库龄结构、计算存货周转情况，并分析其合理性；对比预计售价与期后实际售价是否存在重大差异；分析公司存货计提比例与同行业对比是否存在重大差异；

（3）针对固定资产减值我们实施的审计程序主要包括：①获取公司固定资产明细表，复核相关机器设备在300mm、200mm及以下的拆分是否准确；②了解公司关于固定资产是否存在减值迹象的判断依据及合理性；③了解公司固定资产减值准备计提政策，判断是否符合企业会计准则的规定，复核公司固定资产减值测试的方法、重要假设和关键参数，复核减值测试结果的准确性、合理性。

2、核查意见

基于我们执行的审计程序，我们认为，就2025年度财务报表整体公允反映而言，公司对商誉减值准备计提、存货跌价准备计提、固定资产减值准备计提相关的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的相关规定。

三、关于货币资金。

年报显示，2025年末公司货币资金余额60.74亿元，期末短期借款、长期借款、应付债券、股东借款等有息负债约97.88亿元。报告期内，公司利息收入0.45亿元、利息费用2.26亿元。

请公司：（1）结合货币资金与利息收入的具体构成、计算过程，说明货币资金收益率及与同期银行存款利率是否存在较大差异及原因；（2）补充有息负债的具体用途，结合公司日常经营资金需求、扩产建设资本开支计划、债务到期偿付安排等，说明在账面货币资金余额较高的情况下，同时存在大规模有息负债的原因及合理性；（3）对比同行业可比公司货币资金及有息负债规模、存贷比例、利息收支水平等，说明公司货币资金及有息负债占比较高是否符合行业经营特点，如存在明显差异，请说明具体原因。

回复：

（一）结合货币资金与利息收入的具体构成、计算过程，说明货币资金收益率及与同期银行存款利率是否存在较大差异及原因

1、货币资金的具体构成

报告期各期末，公司货币资金分为库存现金、银行存款、其他货币资金三类，同时按使用权限划分为可自由支配资金与受限资金，具体明细如下：

单位：人民币 万元

项目	2025年末	2024年末
库存现金	0.79	0.08
银行存款	542,284.24	470,927.27
应收利息	2,409.56	2,302.69
其他货币资金	62,706.63	42,322.27
合计	607,401.22	515,552.32
其中：存放在境外的款项总额	36,018.93	52,662.47

注：公司的其他货币资金为银行贷款和开立信用证所存入的保证金存款。

其中银行存款及其他货币资金按产品类型可进一步划分为活期存款、定期存款（含大额存单）、7天通知存款等，各类型存款的余额及占比情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2025年末		2024年末	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
活期存款（含协定）	417,967.67	69.09	289,731.04	56.45
定期存款	150,523.20	24.88	177,618.50	34.61
7天通知存款	36,500.00	6.03	45,900.00	8.94
合计	604,990.87	100.00	513,249.54	100.00

2、利息收入的具体构成与收益率计算过程

报告期内，公司利息收入对应货币资金的收益来源主要包括活期存款利息、定期存款利息等，具体构成明细如下：

单位：人民币 万元

项目	2025年		2024年	
	金额	货币资金综合收益率（%）	金额	货币资金综合收益率（%）
活期存款（含协定）	1,741.43	0.65	4,038.24	1.00
定期存款	2,076.52	1.27	3,161.17	2.08
7天通知存款	646.69	1.57	1,478.65	2.33
合计	4,464.64	0.95	8,678.06	1.40

注1：货币资金综合收益率=当期利息收入÷当期货币资金平均余额；当期货币资金平均余额=（期初货币资金余额+期末货币资金余额）÷2

注2：2025年当期货币资金平均余额计算时剔除了2025年12月发行但2025年未未使用的募集资金在活期存款中的余额17.5亿元。

3、与同期银行存款利率的对比及差异原因

报告期内，公司货币资金综合收益率与同期央行基准存款利率、银行存款挂牌利率的对比情况如下：

单位：%

存款类型	期限	央行基准	国有四大行			
		2015.10.24	2024.7.25前	2024.7.25	2024.10.18	2025.5.20
活期	活期	0.35	0.2	0.15	0.1	0.05
整存整取	3个月	1.10	1.15	1.05	0.8	0.65
整存整取	6个月	1.30	1.35	1.25	1.0	0.85
整存整取	1年	1.50	1.45	1.35	1.1	0.95
协定存款	—	1.15	0.7	0.6	0.2	0.1
通知存款	7天	1.35	0.8	0.7	0.45	0.3

注1：央行基准利率自2015年10月24日后未更新发布过，数据来源于货币政策司；

注2：国有四大行：中国政府直接管控的四家大型商业银行，分别为?中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。

经对比，公司货币资金收益率均优于同期银行存款利率，主要原因为：银行为优质客户提供差异化定价；外币存款的利率高于人民币存款利率；报告期内大额资金收支的时点性差异，导致期初、期末余额无法完全反映资金实际持有周期，形成测算口径下的合理偏差。

综上，公司货币资金收益率与同期银行存款利率的差异具备合理性，且2025年度较2024年度货币资金收益率下降与银行存款利率的下行趋势一致，不存在异常偏离情形。

（二）补充有息负债的具体用途，结合公司日常经营资金需求、扩产建设资本开支计划、债务到期偿付安排等，说明在账面货币资金余额较高的情况下，同时存在大规模有息负债的原因及合理性

1、有息负债的具体构成与资金用途及到期偿付安排

公司有息负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债、应付股东借款及租赁负债等，剔除因租赁产生的租赁负债以及期末计提的应计利息后，公司于2025年年末的有息负债的本金余额为96.32亿元，根据资金用途分类具体如下：

单位：人民币 亿元

资金用途	借款类型	本金余额	1年内还款	1-2年还款	2-3年还款	3-4年还款	5年及以后还款
已建成项目的存量债务	长期借款	20.98	2.00	3.22	3.84	4.07	7.85
已建成项目的存量债务	公司债	10.00	10.00				
200mm半导体特色硅片扩产项目	长期借款	13.68	1.89	2.99	2.20	2.20	4.40
集成电路用300mm硅片产能升级—太原项目	长期借款	6.64	-	-	0.48	0.55	5.61
集成电路用300mm硅片产能升级—上海项目	应付股东借款	10.00	10.00	-	-	-	-
集成电路用300mm硅片产能升级—太原项目	中期票据	10.00	-	-	-	-	10.00
主营业务营运资金补充	短期借款	12.64	12.64	-	-	-	-
主营业务营运资金补充	长期借款	2.48	0.92	0.99	0.57	-	-
存量债务置换	中期票据	5.00	-	-	-	5.00	-
总部大楼	长期借款	1.50	0.00	0.00	0.01	0.01	1.48
产业类股权投资	公司债	3.40	3.40				
总计	/	96.32	40.85	7.20	7.10	11.83	29.34

其中：公司因已建成项目的存量债务30.98亿元，因重大在建项目的新增长期借款、新增应付债券和应付股东借款40.32亿元，因公司主营业务营运资金补充的短期和长期银行借款15.12亿元，剩余的有息债务主要为置换存量债务、建设总部大楼和为产业类股权投资筹措的资金。

根据债务的偿还安排，公司于2026年需要还款的金额为40.85亿元，未来2-3年需要还款的金额为14.3亿元，公司总体资金需求较大，已超过公司于2025年末货币资金中银行存款的余额。

2、公司日常资金需求与资本开支计划

（1）日常经营资金需求

公司2023、2024、2025年度的经营活动现金流分别为-2.74亿元、-7.88亿元、-5.60亿元，为应对日常运营的资金需求，公司需要储备一定量的货币资金。

（2）扩产建设与资本开支计划

基于公司长期发展战略与市场需求增长，报告期内及未来一定期间内，公司在在大规模境内产能扩建、产线升级等资本开支计划，对应资金需求总额、已建进度和预计建设周期如下：

在建项目名称	建设主体	总投资（亿元）	已投资（亿元）	资金来源	预计建成时间	设计产能
300mm高端硅基材料研发中试项目	新傲科技及其控股子公司新傲芯翼	21.44	9.06	定增资金及借款	2026年	40万片/年
200mm半导体特色硅片扩产项目	Okmetic	29.9	23.14	自有资金及借款	预计26年底完成原一期157.2万片/年的产能安装	313.2万片/年
集成电路用300mm硅片产能升级—太原项目	太原晋科硅材料	91.00	51.46	自有资金及借款	2027年	建设拉晶产能60万片/月（含重掺）、切磨抛产能20万片/月（含重掺）
集成电路用300mm硅片产能升级—上海项目	上海新昇	41.00	2.95	自有资金及借款	2027年	建设切磨抛产能40万片/月

前述扩产项目投资规模大、建设周期长，公司需按工程进度分阶段持续投入资金。为保障项目建设节奏不受现金流波动影响，公司需提前储备对应建设资金，形成期末货币资金余额中较大规模的项目专项备付资金。

综上，为防范集中偿付压力、维护公司市场信用与融资渠道稳定性，公司需结合债务到期节奏保留足额的偿债备付资金，与日常营运资金、项目建设资金形成统筹安排。

3、账面货币资金余额较高的构成与留存必要性

报告期各期末公司货币资金余额较高，系公司结合经营、扩产、偿债三重需求作出的主动资金安排，并非全部可自由支配用于提前偿还债务，核心构成及留存原因如下：

（1）专项受限资金

包括募集资金专户资金（按监管要求专款专用，仅可用于对应募投项目建设，不得随意变更用途）、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等，该类资金使用受限，无法用于偿还一般性有息负债。

（2）扩产建设专项备付资金

对应境内产能扩建等资本开支项目，公司根据项目建设进度与付款计划，提前筹措并留存了专项建设资金，将随工程推进、设备交付等节点逐步支付。该部分资金具有明确的投向与使用计划，属于已规划的待支出资金，因此不能用于抵偿存量有息负债。

（3）日常营运与偿债安全储备

为保障生产经营连续性、应对市场环境波动，同时匹配债务到期偿付节奏，公司维持了合理规模的流动性安全储备，用于覆盖日常周转缺口与阶段性偿债需求，避免因资金链紧张影响正常经营与项目建设。

4、货币资金与有息负债并存的合理性总结

（1）资金用途与留存目的明确错配

公司有息负债主要对应中长期扩产项目建设与常态化营运资金补充；而账面货币资金中包含大量已明确用途的项目待支出资金、专项受限资金及偿债备付资金，二者不存在直接替代关系，并非闲置资金与高成本负债并存。

（2）期限结构与业务周期高度匹配

扩产类有息负债以中长期融资为主，与项目2-3年的建设周期、投产回报周期相匹配；货币资金则按项目进度分阶段逐步释放，同时覆盖短期营运与偿债需求，形成“长债对应长周期投入、资金分阶段使用”的合理结构。

（3）资金策略具备整体经济性

结合当前融资成本水平与项目投资回报预期，通过债务融资支持产能扩张、同时保留充足资金储备保障建设与经营稳定性，其带来的长期经营收益与战略价值，高于提前偿债产生的短期成本节约，符合公司整体利益与股东长远回报。

（4）风险防控与经营连续性保障

充足的资金储备可有效应对行业周期波动、项目建设超支等潜在风险，避免因资金不足导致扩产进度延后、经营周转受阻，是公司稳健经营的必要保障。

综上，公司在保有较高货币资金余额的同时维持一定规模有息负债，具备充分的商业合理性与必要性。

（三）对比同行业可比公司货币资金及有息负债规模、存贷比例、利息收支水平等，说明公司货币资金及有息负债占比较高是否符合行业经营特点，如存在明显差异，请说明具体原因。

1、可比公司对比情况

公司选取主营业务、经营模式、规模体量具有可比性的公司作为同行业可比样本，最终确定可比公司为：西安奕材、中欣晶圆、TCL中环、立昂微。报告期各期末，公司与同行业可比公司的货币资金、有息负债及利息收支相关指标对比情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2025年末		2024年末	
	金额	占比	金额	占比
货币资金				
西安奕材	352,631.18	17.04%	335,004.52	19.23%
中欣晶圆	49,683.28	3.10%	62,885.73	4.08%
TCL中环	1,191,130.35	10.09%	1,281,680.92	10.20%
立昂微	199,993.05	10.40%	230,359.69	11.92%
平均值	-	10.16%	-	11.36%
沪硅产业	607,401.22	17.98%	515,552.32	17.61%
有息负债				
西安奕材	646,423.49	31.23%	700,668.78	40.22%
中欣晶圆	728,170.87	45.43%	645,479.80	41.85%
TCL中环	5,837,577.64	49.46%	5,765,629.20	45.91%
立昂微	898,971.20	46.76%	878,788.73	45.48%
平均值	-	43.22%	-	43.36%
沪硅产业	879,494.25	26.03%	645,633.63	22.06%

注：为保持与可比公司口径一致，表格中统计的有息负债=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款合计+租赁负债。

近两年末，公司货币资金占总资产比例分别为17.61%和17.98%，高于同行业可比公司平均水平。主要系公司当前处于产能扩张建设期，半导体硅片产线具有投资规模大、建设周期长、设备采购额高的特点，需阶段性储备大额货币资金以保障在建工程款项支付、设备采购等资本性支出。同时，公司采取稳健的流动性管理策略，保留更高比例的安全资金储备，以应对半导体行业周期性波动、供应链变动等潜在风险，增强经营抗风险能力。

近两年末，公司有息负债占总资产比例分别为22.06%和26.03%，低于同行业可比公司平均水平。主要系公司通过股权融资筹措了大量的产能建设所需资金，对债务融资的依赖度相对较低。并且，公司秉持稳健的财务理念、注重控制财务杠杆水平，通过合理管控债务规模降低利息支出与偿债压力，规避高杠杆经营在行业下行周期可能引发的流动性风险。

公司与同行业可比公司的存贷比、货币资金综合收益率、有息负债综合利息成本率情况如下：

项目	2025年	2024年
存贷比（货币资金/有息负债）		
西安奕材	54.55%	47.81%
中欣晶圆	6.82%	9.74%
TCL中环	20.40%	22.23%
立昂微	22.25%	26.21%
平均值	26.01%	26.50%
沪硅产业	69.06%	79.85%
货币资金综合收益率		
西安奕材	1.12%	1.20%
中欣晶圆	1.28%	3.43%
TCL中环	1.11%	1.33%
立昂微	0.49%	0.97%
平均值	1.00%	1.73%
沪硅产业	0.74%	1.68%
有息负债综合利息成本率		
西安奕材	3.00%	2.81%
中欣晶圆	3.03%	2.57%
TCL中环	2.81%	2.34%
立昂微	3.15%	2.84%
平均值	3.00%	2.64%
沪硅产业	2.57%	2.65%

注：货币资金综合收益率=当期利息收入/期末货币资金；有息负债综合利息成本率=当期利息费用/期末有息负债。

近两年末，公司存贷比指标分别为79.85%和69.06%，高于同行业可比公司平均水平。公司较高的货币资金水平和较低的有息负债水平共同形成了存贷比较高的情形，具体原因详见前文分析。

近两年，公司货币资金综合收益率分别为1.68%和0.74%，与可比公司平均水平基本一致。

近两年，公司有息负债综合利息成本分别为2.65%和2.57%，低于同行业可比公司平均水平。主要系公司作为国内半导体硅片领域的核心企业，主体信用资质良好，融资渠道多元，可获得商业银行较低利率的项目贷款与流动资金贷款，同时可通过债券融资等多元化方式优化融资成本。

结合前述可比公司数据，公司呈现货币资金占总资产比例高于同行业可比公司均值、有息负债占总资产比例低于同行业可比公司均值的财务结构特征。半导体硅片行业属于典型的资本开支规模大、建设周期长的高端制造行业，公司货币资金占总资产比例高于同行业可比公司平均水平，本质是对半导体硅片行业资金需求特征的强化体现，符合行业经营特点。近两年公司处于产能扩张与产线爬坡的关键阶段，在建工程、设备采购款项支付规模大、节点密集，维持较高比例的货币资金储备，是保障产能建设进度、避免资金链断裂风险的行业通行做法。同行业可比公司中，西安奕材近两年的货币资金占比与公司水平接近，印证了扩张期企业高资金储备的行业共性。

半导体硅片行业的重资产属性决定了债务融资是行业内企业的重要资金来源，但有息负债占比并无统一标准，行业内企业因融资路径、发展阶段、财务策略不同呈现显著分化。公司作为国内半导体硅片领域的上市龙头，历史期间通过IPO、定增等股权融资方式募集了大额长期资金，能够以股权资金覆盖主要资本开支，对债务融资的依赖度相对较低。该差异系融资渠道不同导致的正常分化，符合行业融资规律。

综上所述，报告期内公司货币资金占比、有息负债占比、存贷比、货币资金综合收益率、有息负债综合利息成本等指标与同行业可比公司存在的差异，均与公司所处发展阶段、行业经营特性、业务模式及财务策略相匹配，符合公司实际经营情况，具备商业合理性。

（四）会计师核查程序和核查意见：

1、核查程序

（1）获取公司有息负债明细、货币资金明细及银行对账单，执行银行函证程序等，核查借款规模、资金使用（用途）受限情况及原因；

（2）通过银行函证结果和公开渠道获取存款利率信息和变动趋势，根据资金余额和结构以及测算的平均收益率分析货币资金与利息收入的匹配性，按照存款本金、实际执行利率和实际存续天数，复核主要银行账户、定期存款及通知存款的利息收入计算是否正确；

（3）了解公司主要扩产项目的投资预算、建设进度、资金需求；了解有息负债的用途及到期时间；了解公司在账面货币资金余额较高的情况下，同时存在大规模有息负债的原因；

（4）查询同行业可比公司定期报告等公开资料，了解同行业可比公司货币资金规模、有息负债规模、存贷比、利息收支水平情况，分析与公司的差异及合理性。

2、核查意见

（1）公司货币资金收益率处于合理水平，与同期银行存款利率不存在显著差异；

（2）公司关于有息负债的用途、在账面货币资金余额较高的同时存有大规模有息负债的原因说明，以及是否符合行业经营特点的说明，与我们执行公司财务报表审计过程中了解的相关情况没有重大不一致。

四、关于预付款项和其他非流动资产。

年报显示，2025年末，公司预付款项3.44亿元，同比增长37.07%，其中账龄一年以上的预付款项1.22亿元，主要为预付材料采购款项。此外，公司其他非流动资产期末余额11.79亿元，同比增长57.96%，其中预付长期资产采购款10.76亿元，交货期在一年以后的预付货款1.02亿元。

请公司：（1）列示期末预付款项以及其他非流动资产中预付采购款和长期资产购置款的主要对象名称及与上市公司关联关系、成立时间、主营业务、经营规模、合作历史、采购或购置内容及用途、预付原因、预付款余额、挂账时间及期后结算情况等；（2）结合行业惯例、同行业公司情况以及公司扩产节奏、采购及生产周期等，说明前述预付款的商业背景及必要性、合理性，以及报告期内预付款大幅增加的原因；（3）结合合同签订后的实际执行情况（包括付款、交付、结算及退换货情况等），以及后续的交付及结算安排，说明是否存在预付对象无法正常履约的风险。

回复：

（一）列示期末预付款项以及其他非流动资产中预付采购款和长期资产购置款的主要对象名称及与上市公司关联关系、成立时间、主营业务、经营规模、合作历史、采购或购置内容及用途、预付原因、预付款余额、挂账时间及期后结算情况等：

公司预付账款主要为预付材料采购款、能源费、维修费以及预付租赁款等。公司其他非流动资产中的长期资产购置款，主要系公司为扩产项目而预付的机器设备购置款。

截至2025年12月31日，公司预付款项的前十大供应商具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	供应商	是否为关联方	成立时间	主营业务	经营规模	合作历史	采购内容及用途	预付款余额	账龄-1年以内	账龄-1年以上
1	供应商一	否	1914年	*	大型	10年以上	原材料	18,825.32	10,913.37	7,911.95
2	供应商二	否	1982年	*	大型	5-10年	原材料	2,003.53	1,268.73	734.80